

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

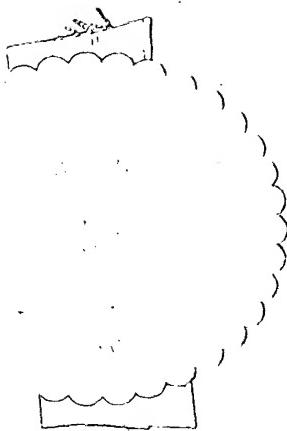
別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 2月 28日
Date of Application:

出願番号 特願 2003-054572
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP 2003-054572]

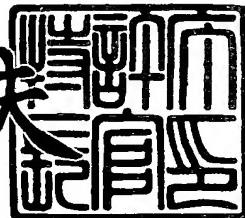
出願人 日本特殊陶業株式会社
Applicant(s):



2004年 1月 26日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 AX0227417N
【提出日】 平成15年 2月28日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 H01L 23/50
【発明者】
【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内
【氏名】 斎木 一
【発明者】
【住所又は居所】 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内
【氏名】 中田 道利
【特許出願人】
【識別番号】 000004547
【氏名又は名称】 日本特殊陶業株式会社
【代理人】
【識別番号】 100095751
【弁理士】
【氏名又は名称】 菅原 正倫
【電話番号】 052-212-1301
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 003388
【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 9714967

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ボール付樹脂製配線基板

【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁性の基板に貫通形成されたスルーホール、及び該スルーホールの内周面に形成された略筒状のスルーホール導体、及び該スルーホール導体の中空部に充填された充填材、を有するコア基板と、

前記コア基板の少なくとも一方の主面上において、前記スルーホールの端面を含む形にて形成され、かつ前記スルーホール導体と導通する蓋状導体層と、

前記蓋状導体層上に形成された複数の樹脂層と、

前記複数の樹脂層上に形成され、外部機器の接続端子と接続可能なハンダボールが設置されているボールパッド導体と、

前記蓋状導体層と前記ボールパッド導体とを導通させるよう前記複数の樹脂層のそれぞれに埋設されたビア導体からなる接続部と、

を備えるボール付樹脂製配線基板であって、

前記接続部のうち、前記蓋状導体層に接続されるビア導体はコンフォーマルビア、その他のビア導体はフィルドビアからなるとともに、前記スルーホールの貫通方向を中心軸線方向とした場合、前記フィルドビアからなるビア導体及び前記ボールパッド導体のそれぞれの中心軸線は、前記スルーホールの中心軸線と一致しないことを特徴とするボール付樹脂製配線基板。

【請求項2】 前記ボールパッド導体の中心軸線は、前記スルーホール上に位置しないことを特徴とする請求項1記載のボール付樹脂製配線基板。

【請求項3】 前記フィルドビアからなるビア導体のうち少なくとも前記ボールパッド導体に接続されるビア導体は、前記スルーホール上に位置しないことを特徴とする請求項1または2に記載のボール付樹脂製配線基板。

【請求項4】 前記フィルドビアからなるビア導体は、前記スルーホール上に位置しないことを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載のボール付樹脂製配線基板。

【請求項5】 前記スルーホールの径は、 $100\mu m$ 以上 $300\mu m$ 以下であることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載のボール付樹脂製配線

基板。

【請求項 6】 前記略筒状のスルーホール導体の平均壁厚は $10 \mu\text{m}$ 以上 $30 \mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする請求項 5 記載のボール付樹脂製配線基板。

【請求項 7】 前記フィルドビアからなるビア導体のそれぞれの中心軸線は、前記スルーホールの中心軸線からの距離が $50 \mu\text{m}$ 以上 $150 \mu\text{m}$ 以下となることを特徴とする請求項 5 または 6 に記載のボール付樹脂製配線基板。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明が属する技術分野】

本発明はボール付樹脂製配線基板に関し、詳しくは半導体集積回路素子（IC）等の電子部品を搭載して封止するBGA（ボールグリッドアレイ）タイプのパッケージ配線基板のように、スルーホール及びスルーホール導体を有するコア基板と、その上に積層された導体層と樹脂層からなる配線層と、その上に設置されたボールパッド導体（電極）とを備え、配線層にはスルーホール導体とボールパッド導体とを導通させるようにビア導体からなる接続部が形成され、かつボールパッド導体にはマザーボード等の外部機器と接続可能なハンダボールが設置されてなるボール付樹脂製配線基板に関する。

【0002】

【従来の技術】

BGAタイプの配線基板は、その一主面にLSIやICチップなどの電子部品を搭載する際に用いる、多数のパット状の電極を備えており、他方の主面にはマザーボードなどと接続するための多数のボールパッド導体（電極）及びそれに設置されたハンダボール（入出力端子）を備えたものとされている。このようなタイプのボール付樹脂製配線基板においては、搭載するLSIやICチップあるいはチップコンデンサなどの電子部品の高集積化および高密度化を図るために、小型化や接続端子数（ボール数）の増大化が進められている。

【0003】

このようなボール付樹脂製配線基板の内部構造としては、絶縁性の基板に形成されたスルーホール内に、スルーホール導体及び充填材を有するコア基板と、ス

ルーホールの一方の端面上に形成された蓋状導体層、樹脂層、ボールパッド導体、及びハンダボール（入出力端子）と、スルーホール導体とボールパッド導体（それに設置されたハンダボール）とを導通させるよう樹脂層に埋設されたビア導体と、を備えたものが一般的である。

【0004】

【特許文献1】

特開2000-91383号公報

【特許文献2】

特開平10-341080号公報

【特許文献3】

特開2000-307220号公報 (段落【0014～15】)

【特許文献4】

特開2000-340951号公報 (段落【0014～15】)

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

上記のようなボール付樹脂製配線基板においては、製造の際などに行われる熱サイクルの過程で次のような問題が生じる。樹脂製配線基板の核となるコア基板には、2つの主面間を導通させるために、樹脂等からなる絶縁材基板の所定位置に厚さ方向を突き抜ける金属層が形成されている。金属と樹脂では熱膨張率が異なるため、熱サイクルによるコア基板の厚さ方向の膨張／収縮は位置によって偏りが生じる。このため、コア基板上に積層された層においては、コア基板の膨張／収縮により加わる力が不均一なものとなり、その結果、接続部を構成するビア導体の接合面等でクラックが発生し、スルーホール導体からボールパッド（それに設置されたハンダボール）への電気的な接続が断ち切られやすくなってしまうという問題が生じていた。このことは、樹脂配線基板に求められる電気的特性などの品質が保持されないことに繋がる。

【0006】

本発明は、まさに上記課題を鑑みてなされたものである。樹脂製配線基板のボールパッド導体にハンダボールが設置されたボール付樹脂製配線基板を対象とし

、電気的特性の信頼性の高いボール付樹脂製配線基板を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段及び作用・発明の効果】

上記課題を解決するため、本発明のボール付樹脂製配線基板では、

絶縁性の基板に貫通形成されたスルーホール、及び該スルーホールの内周面に形成された略筒状のスルーホール導体、及び該スルーホール導体の中空部に充填された充填材、を有するコア基板と、

前記コア基板の少なくとも一方の主面上において、前記スルーホールの端面を含む形にて形成され、かつ前記スルーホール導体と導通する蓋状導体層と、

前記蓋状導体層上に形成された複数の樹脂層と、

前記複数の樹脂層上に形成され、外部機器の接続端子と接続可能なハンダボールが設置されているボールパッド導体と、

前記蓋状導体層と前記ボールパッド導体とを導通させるよう前記複数の樹脂層のそれぞれに埋設されたビア導体からなる接続部と、

を備えるボール付樹脂製配線基板であって、

前記接続部のうち、前記蓋状導体層に接続されるビア導体はコンフォーマルビア、その他のビア導体はフィルドビアからなるとともに、前記スルーホールの貫通方向を中心軸線方向とした場合、前記フィルドビアからなるビア導体のそれぞれの中心軸線は、前記スルーホールの中心軸線と一致しないことを特徴とする。

【0008】

一般に、樹脂材の熱膨張率は、金属材のそれよりも大きい。ボール付樹脂製配線基板1（図3（a）に示す）が加熱された場合、コア基板2を構成する略筒状のスルーホール導体22（金属材）、及びスルーホール導体22の中空部に充填された充填材23（樹脂材）、スルーホール21を有する絶縁性の基板材25（樹脂材：スルーホール導体22の周囲に位置する）は、それぞれ板厚方向に膨張するが、図3（b）に示すように、スルーホール導体22（金属材）の膨張が周囲の樹脂材23、25と比べ小さくなる。そして、スルーホール導体22に接続された蓋状導体層24により、充填材23の端面のうち周縁付近が抑え付けられ、充填材23の膨張は妨げられる。その結果、充填材23の膨張はスルーホール

21の中心軸線211付近に集中し、その上の蓋状導体層24及び樹脂層3を突き上げる。また、ボール付配線基板1が冷却された場合には、それとは逆の現象が起き、図3(c)に示すように、スルーホール21の中心軸線211付近に充填材23の収縮が集中し、その上の蓋状導体層24及び樹脂層3を引き下げる。したがって、スルーホール21の中心軸線211位置に、フィルドビア(後述)からなるビア導体75、76の中心軸線756やボールパッド導体4の中心軸線411があれば、コア基板2からの突き上げ／引き下げの影響を受け易く、蓋状導体層24とビア導体75の間、及びビア導体間(ビア導体75及び76の間)、ビア導体76とボールパッド導体4の間に過度の応力集中が生じ、それらの電気的接続が断ち切られやすくなってしまう(図3では、蓋状導体層24とビア導体75の間の接続が断ち切られた場合を示す)。

【0009】

ビア導体には、自身を形成するために樹脂層に開けられた穴において、全てを金属材で満たしたフィルドビアと、穴壁に沿って金属材を配し、残り部分を樹脂材で埋めたコンフォーマルビアとの2種類が存在する。前述したように、樹脂材の熱膨張率は金属材のそれよりも小さいため、コア基板や樹脂層の膨張／収縮に伴って発生する外力が加わったときに、コンフォーマルビアは内側の樹脂材の膨張に起因する反発力を生み出しやすく、全て金属材からなるフィルドビアと比べて外力の影響を受け難い。そこで、コア基板上の蓋状導体層に接続されるビア導体をコンフォーマルビアで構成することにより、上記のようなコア基板からの突き上げ／引き下げの影響を受け難くすることが可能となる。

【0010】

また、接続部のうち、蓋状導体層に接続されるビア導体以外のビア導体、なかもボールパッド導体と接続されるビア導体を、フィルドビアで構成することにより、ビア導体とボールパッド導体(及びそれに設置されるハンダボール)との電気的接続の確実性を確保することができる。しかし、前述したようにフィルドビアはコンフォーマルビアと比べて外力の影響を受け易いため、それぞれのフィルドビアの中心軸線を、コア基板からの突き上げ／引き下げの影響が大きいスルーホール中心軸線上に位置しないよう配置する。

【0011】

さらに、ボールパッド導体に関しても、その中心軸線をスルーホールの中心軸線と一致しないよう配置することで、コア基板からの突き上げ／引き下げの影響を受け難くすることが可能となる。

【0012】

なお、ここでいう中心軸線とは、スルーホールの貫通方向と同方向で、かつそれぞれスルーホール、ビア導体、及びボールパッド導体を、前記貫通方向と垂直に交わる面に投影した略円形状の投影像における中心位置を通るものとする。

【0013】

次に、本発明のボール付樹脂製配線基板では、前記ボールパッド導体の中心軸線は、前記スルーホール上に位置しないことを特徴とする。ボールパッド導体の径は、外部機器と接続するハンダボールの径に依存して設定されるため（例えば $700\mu m$ 程度）、高集積化された配線基板内部のスルーホールの径（例えば $150\mu m$ 程度）と比べて約4倍程度大きく形成される。そのため、ボールパッドの中心軸線がスルーホールの中心軸線から外れても、スルーホール上にある場合、十分にコア基板からの突き上げ／引き下げの影響を回避できないことが想定される。そこで、上記のようにボールパッド導体を配置することで、そのような影響をさらに受け難くすることが可能となる。

【0014】

次に、前記接続部を構成する前記ビア導体では、前記フィルドビアからなるビア導体のうち少なくとも前記ボールパッド導体に接続されるビア導体は、前記スルーホール上に位置しないことを特徴とする。このように構成することで、ビア導体とボールパッド導体との接続部分をスルーホール上に位置しないようにすることができるので、ビア導体とボールパッド導体（及びそれに設置されるハンダボール）との電気的接続の確実性をより確保することが可能となる。

【0015】

次に、本発明のボール付樹脂製配線基板では、前記フィルドビアからなるビア導体は、前記スルーホール上に位置しないことを特徴とする。フィルドビアからなるビア導体は、スルーホール上にある場合、十分にコア基板からの突き上げ／

引き下げの影響を回避できないことが想定される。そこで、上記のようにフィルドビアからなるビア導体をスルーホール上に位置しないよう配置することで、そのような影響をさらに受け難くすることが可能となる。

【0016】

本発明において、前記スルーホールの径は、 $100\mu m$ 以上 $300\mu m$ 以下とされる。スルーホールの径が過度に大きい場合、図2に示すコア基板2の膨張のように、スルーホール21の中心軸付近よりも、熱膨張率の小さいスルーホール導体22上での引き下げによる過度の応力集中が生じやすくなってしまうため、フィルドビアからなるビア導体及びポールパッド導体の中心軸線を、スルーホール21の中心軸線と一致させないよう配置することは、逆に不利となってしまう場合がある。また、配線基板の高集積化及び高密度化に不利となってしまうことも考えられる。このような影響を避けるためには、スルーホールの径は $300\mu m$ 以下であることが必要である。また、スルーホール径の下限については、特に限定されないが、現状の配線基板の集積度に応じて、現段階においては $100\mu m$ とされている。さらには、スルーホールの径は $150\mu m$ 以上 $300\mu m$ 以下であることがより好ましい。

【0017】

また、スルーホール径が上記範囲である場合、略筒状のスルーホール導体の平均壁厚は $10\mu m$ 以上 $30\mu m$ 以下とされる。平均壁厚が過度に厚いと、スルーホール導体内部の充填材の膨張がスルーホールの中心軸付近に集中し過ぎてしまい、突き上げによる過度の応力集中が生じ易くなってしまう場合があり、またコスト的にも不利となってしまうことも考えられるので、上限値を $30\mu m$ とする。また、下限値については、特に限定されないが、過度に薄くすると導通が取れない場合が考えられるので、 $10\mu m$ とする。さらには、略筒状のスルーホール導体の平均壁厚は $15\mu m$ 以上 $25\mu m$ 以下であることがより好ましい。

【0018】

さらに、スルーホール、またはスルーホール導体が上記範囲である場合において、前記フィルドビアからなるビア導体のそれぞれの中心軸線は、前記スルーホールの中心軸線からの距離が $50\mu m$ 以上 $150\mu m$ 以下とされる。フィルドビ

アからなるビア導体の中心軸から、スルーホールの中心軸線までの距離が $50\mu m$ より小さいと、コア基板からの突き上げ／引き下げの影響が大きいスルーホールの中心軸線位置に、フィルドビアからなるビア導体の中心軸線が近過ぎてその影響を受け易くなってしまう場合が考えられる。また、その距離が $150\mu m$ よりも大きければ、配線基板の高集積化および高密度化に不利となってしまう場合が考えられる。さらには、フィルドビアからなるビア導体のそれぞれの中心軸線からスルーホールの中心軸線までの距離は $50\mu m$ 以上 $130\mu m$ 以下であることがより好ましい。

【0019】

【発明の実施の形態】

以下、本発明のボール付樹脂製配線基板の実施形態を、図面を参照しつつ説明する。図1は、ボール付樹脂製配線基板1の断面図である。ボール付樹脂製配線基板1は、平面視矩形（例えば、縦横各 50 mm 、厚さ 1 mm ）をなし、図はそのうちの、マザーボード等の外部機器の接続端子と接続可能なハンダボール5が多数設置される主面側の内部構造の一部を拡大した図である。また、図示しないが、これとは反対の主面側には、搭載する半導体集積回路素子IC接続用の電極が多数形成されているとともに、内部には各層の内部配線層、各内部配線層同士を接続するビア導体が形成されている。

【0020】

コア基板2は、BT樹脂を主成分とする樹脂材からなる厚さ 0.8 mm 程度の基板材25に $500\mu m$ 程度の間隔で貫通形成された直径 $150\mu m$ 程度のスルーホール21と、スルーホール21の内周面に形成された略筒状（壁厚 $20\mu m$ 程度）で銅を主成分とする金属材からなるスルーホール導体22と、スルーホール導体22の中空部に充填されたエポキシ樹脂を主成分とする樹脂材からなる充填材23とを備える。コア基板2の表面上には、スルーホール21の端面を含む形にて蓋状導体層24が形成され、スルーホール導体22と導通している。蓋状導体層24は、例えば径が $250\mu m$ 程度、厚さが $30\mu m$ 程度の円柱形で、その中心軸線とスルーホールの貫通方向の中心軸線211とが一致するよう配置される。また、径がスルーホール径（ $150\mu m$ 程度）よりも大きいので、基板材

25上をスルーホール21外縁端から $100\mu m$ 程度覆うような形態となっている。

【0021】

このようなコア基板2上には、エポキシ樹脂を主成分とし、下側樹脂層31と上側樹脂層32の2層からなり、厚さ $60\mu m$ 程度（1層あたり厚さ $30\mu m$ 程度）の複数の樹脂層3が形成される。本形態では複数の樹脂層3は2層からなるが、2層に限らず3層以上であってもよい。そして、上側樹脂層32上には、円柱形の銅を主成分とする導体層が $1.3 mm$ 程度の間隔で多数形成されており、その表面にはニッケルメッキ及び金メッキがかけられることで、ボールパッド導体4をなしている。ボールパッド導体4の大きさは径が $700\mu m$ 程度、厚さが $15\mu m$ 程度となっている。ボールパッド導体4の設置位置は、後述する接続部7のうちの上側フィルドビア72に接続可能な範囲であり、且つボールパッド導体4の中心軸線411からスルーホール21の中心軸線211までの距離PLが、例えば $425\mu m$ 程度に設定されている。

【0022】

なお、上側樹脂層32上において、ボールパッド導体4が配されていない部分については、厚さ $20\mu m$ 程度のソルダーレジスト層6が被覆形成されている。このソルダーレジスト層6は、本形態ではボールパッド導体4の上側主面42の周縁を所定の幅で覆って開口され、ボールパッド導体4の上側主面42の中心より部位を同心状に露出させるように形成されている。因みに本例では、その露出部位（ソルダーレジスト層6の開口、つまりボールパッド導体4の上側主面42うちソルダーレジスト層6に覆われていない部分）の径、つまりボールパッド導体4の上側主面42のハンダ付け面の径は $530\mu m$ 程度に設定されている。

【0023】

ボールパッド導体4の上側主面42にはハンダボール5が略同心状に設置されているが、設置する際に球状のハンダボールを溶融させて設置を行うため、ハンダボール5はボールパッド導体4の上側主面42に向かって濡れ広がったような形態となっている。また、ハンダの量はボールパッド導体4の径の大きさによって適宜選択されるが、形成後のハンダボール5は、ボールパッド導体4の上側主

面42からの高さが $600\mu m$ 程度となることが望ましく、さらにはハンダボーラー5の濡れ広がりが、ボールパッド導体4の上側主面42の周縁端位置を超えないようになるとよい。なお、ハンダは、公知のハンダ（例えば、Pb82% / Sn10% / Sb8%、又はSn95%、Sb5%）が使用されている。

【0024】

複数の樹脂層3において、下側樹脂層31にはコンフォーマルビア71が、上側樹脂層32にはフィルドビア72が埋設されている。コンフォーマルビア71は、樹脂層を貫通するよう形成されたビア孔の穴壁に沿って配された銅を主成分とする金属材712と、残り部分を埋める樹脂層3と同成分の樹脂材713と、フィルドビア72と接続するためにその方向へ伸びている接続層714とからなる。また、フィルドビア72は、樹脂層を貫通するよう形成されたビア孔を、銅を主成分とする金属材で充填することにより形成される。コンフォーマルビア71及びフィルドビア72の最大径は例えば約 $75\mu m$ 程度で構成される。但し、コンフォーマルビア71の径は、接続層714を含まない部分（ビア孔内）によって規定されるものとする。

【0025】

そして、コンフォーマルビア71とフィルドビア72は接続されることにより接続部7を形成しており、さらには、コンフォーマルビア71はその下の蓋状導体層24の上側主面241と、フィルドビア72はその上のボールパッド導体4の下側主面43と接続されることで、蓋状導体層24とボールパッド導体4の間を導通させている。また、フィルドビア72の中心軸線721は、コア基板2の膨張／収縮の影響を受け難くするよう、スルーホール21の中心軸線211からの距離VLが $125\mu m$ 程度となるよう配置されている。なお、本実施形態においては、コンフォーマルビア71の中心軸線711（接続層714を含まない部分により規定される）は、スルーホール21の中心軸線211と一致するよう設置されているが、コンフォーマルビア71の設置位置は、蓋状導体層24の上側主面241に接続可能な範囲ならば特に限定されない。

【0026】

なお、本発明のボール付樹脂製配線基板は、特許文献3（特開2000-30

7220号公報 段落【0014～1・5】)・、特許文献4（特開2000-340951号公報 段落【0014～15】）に記載のような公知のビルドアップ技術（サブトラクティブ法、アディティブ法、セミアディティブ法など）により製造する。

【0027】

【実施例】

ここで、本発明のボール付樹脂製配線基板の具体的な実施例を比較例とともに説明する。上述の実施形態（図1）を実施例とし、比較例は、図3に示すようなフィルドビアからなるビア導体、及びボールパッド導体が、スルーホール中心軸線上に中心軸線を揃えて配置された形態とした。

【0028】

実施例及び比較例について、-55℃～125℃の温度間で加熱、冷却を繰り返す熱サイクル（1サイクル当たり10分間）を、①与える前、②100サイクル後、③500サイクル後の3種類のサンプルをそれぞれ用意し、断面SEM（Scanning Electron Microscope）観察を行い、クラック発生率の評価を行った。図4に評価結果を示す。図中のクラック発生率の分母はサンプルの総数、分子はその中でクラックが見られたサンプルの数を表す。

【0029】

図4の評価結果によると、実施例では①熱サイクル前、②100サイクル後、③500サイクル後のサンプル全てにおいて、SEM像にクラック等の異変は見られなかったのに対し、比較例では、②100サイクル後、及び③500サイクル後の約半数以上のサンプルにクラック発生が認められた。また、①熱サイクル前のサンプルにおいても、既にクラックが発生しているものが見られた。これは、ハンダボール設置時の熱処理によるものと考えられる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明のボール付樹脂製配線基板の内部構造の一部を表す図

【図2】

スルーホール径が大きい場合のコア基板の膨張／収縮

【図3】

コア基板の膨張／収縮が及ぼす影響を示す図

【図4】

クラック発生率

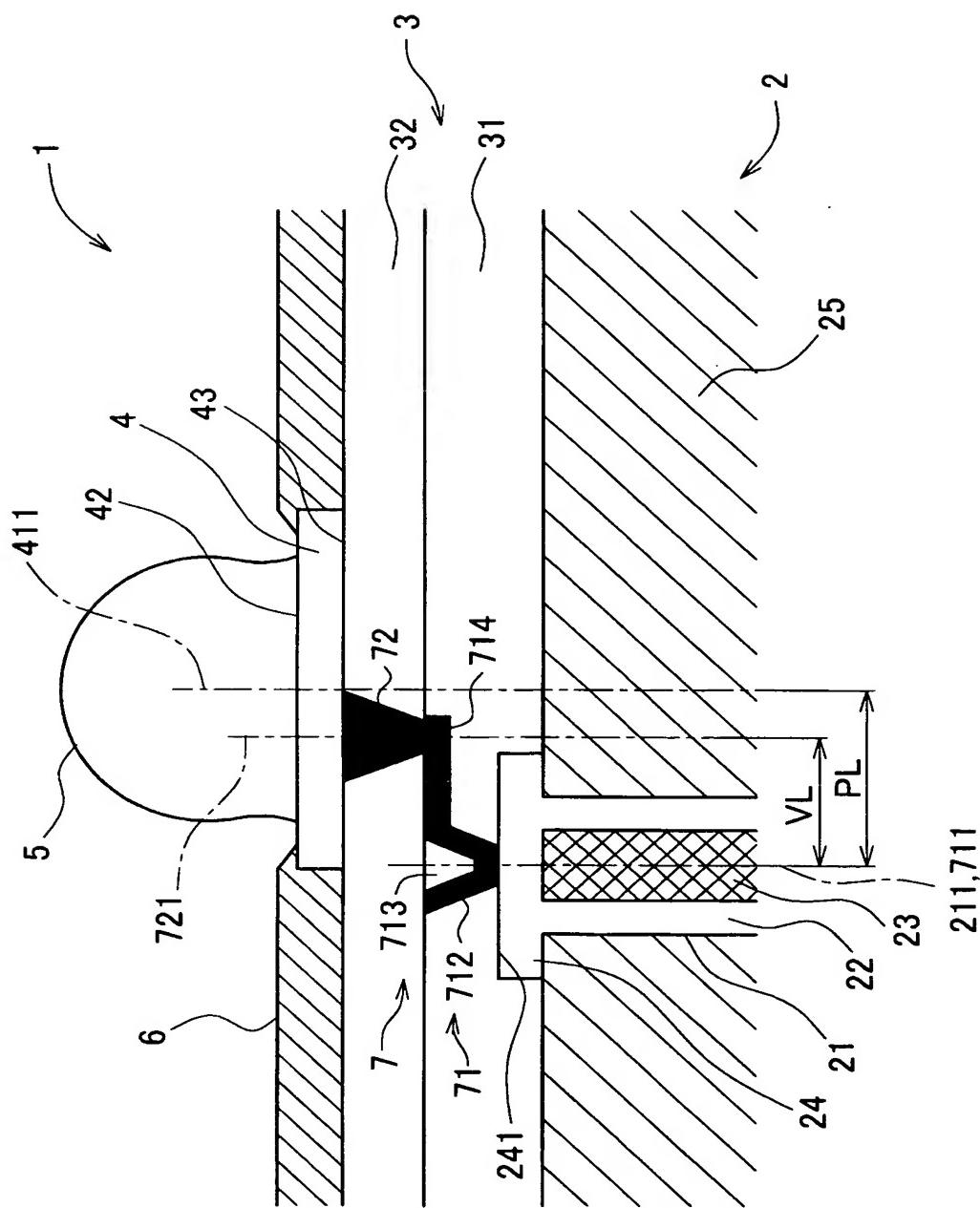
【符号の説明】

- 1 ボール付樹脂製配線基板
- 2 コア基板
- 2 1 スルーホール
- 2 2 スルーホール導体
- 2 3 充填材
- 2 4 蓋状導体層
- 3 樹脂層
- 4 ボールパッド導体
- 5 ハンダボール
- 6 ソルダーレジスト層
- 7 接続部

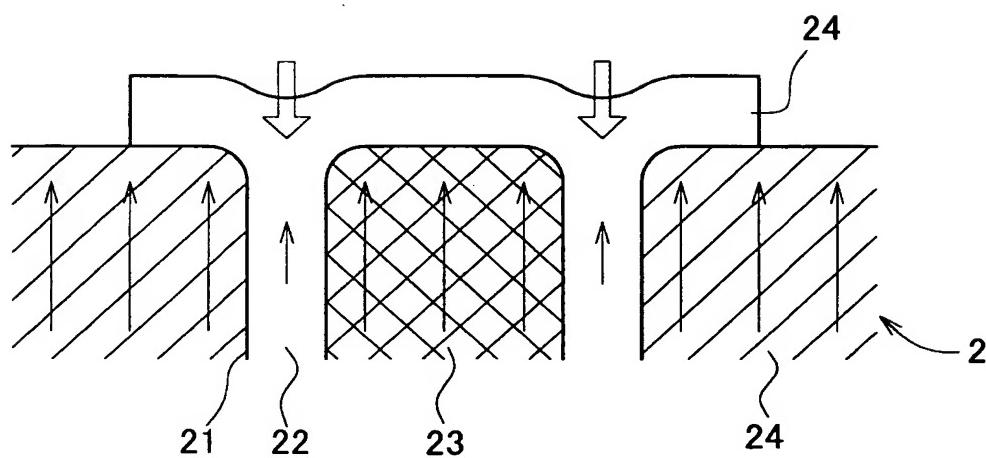
【書類名】

図面

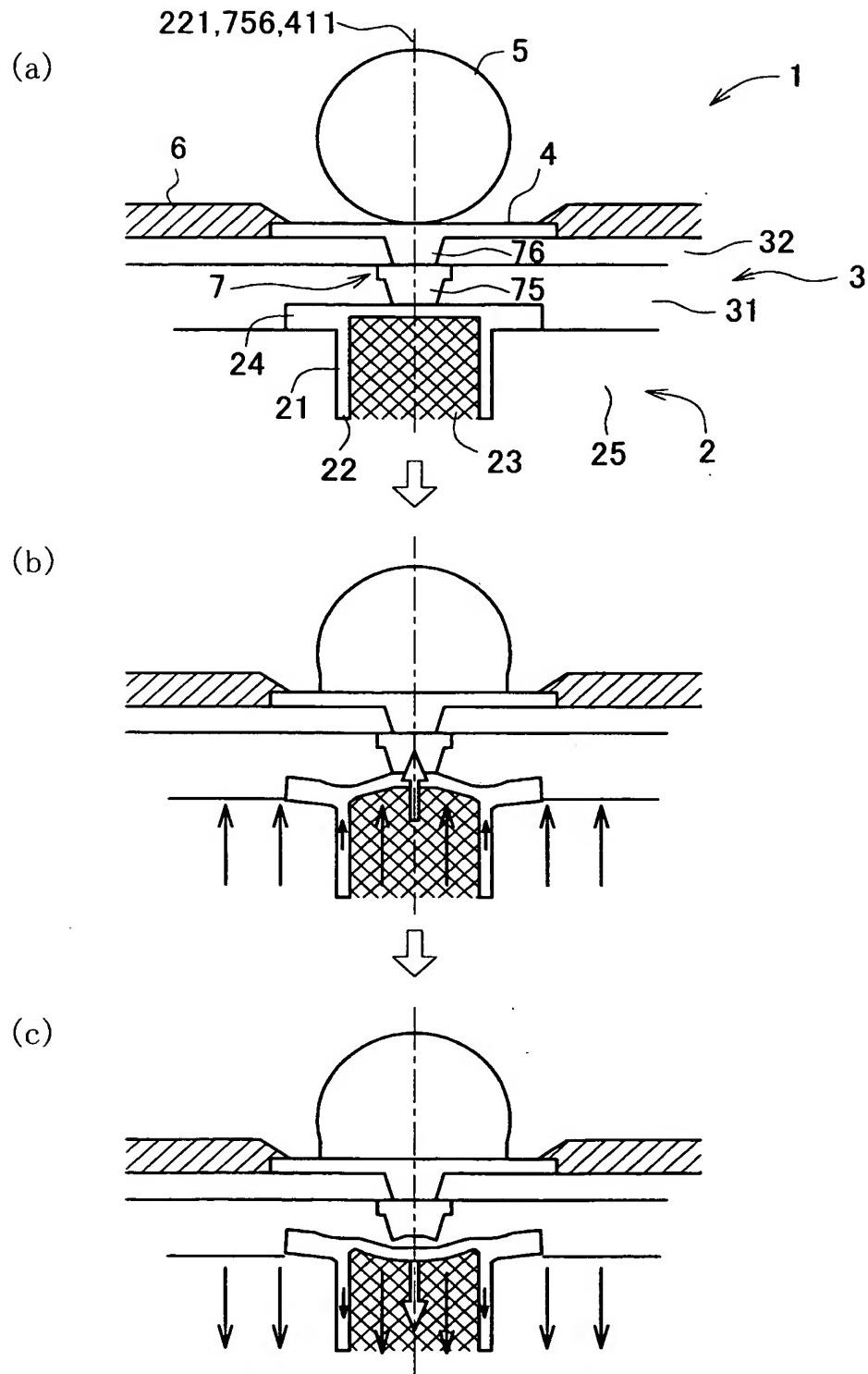
【図1】



【図2】



【図3】



【図4】

	実施例	比較例
①熱サイクル無し	0/30	8/17
②100サイクル後	0/30	26/51
③500サイクル後	0/30	10/18

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明は、樹脂製配線基板のボールパッド導体にハンダボールが設置されたボール付樹脂製配線基板を対象とし、電気的特性の信頼性の高いボール付樹脂製配線基板を提供する。

【解決手段】 本発明のボール付樹脂製配線基板では、

絶縁性の基板に貫通形成されたスルーホール、及び該スルーホールの内周面に形成された略筒状のスルーホール導体、及び該スルーホール導体の中空部に充填された充填材、を有するコア基板と、

前記コア基板の少なくとも一方の主面上において、前記スルーホールの端面を含む形にて形成され、かつ前記スルーホール導体と導通する蓋状導体層と、

前記蓋状導体層上に形成された複数の樹脂層と、

前記複数の樹脂層上に形成され、外部機器の接続端子と接続可能なハンダボールが設置されているボールパッド導体と、

前記蓋状導体層と前記ボールパッド導体とを導通させるよう前記複数の樹脂層のそれぞれに埋設されたビア導体からなる接続部と、

を備えるボール付樹脂製配線基板であって、

前記接続部のうち、前記蓋状導体層に接続されるビア導体はコンフォーマルビア、他のビア導体はフィルドビアからなるとともに、前記スルーホールの貫通方向を中心軸線方向とした場合、前記フィルドビアからなるビア導体のそれぞれの中心軸線は、前記スルーホールの中心軸線と一致しないことを特徴とする。

【選択図】 図1

特願 2003-054572

出願人履歴情報

識別番号 [000004547]

1. 変更年月日 1990年 8月 8日

[変更理由] 新規登録

住所 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号
氏名 日本特殊陶業株式会社